



## 平成 26 年5月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 26 年3月 27 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011  
 四半期報告書提出予定日 平成 26 年4月 14 日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 26 年5月期第3四半期の業績(平成 25 年6月 1 日～平成 26 年2月 28 日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26 年5月期第3四半期	31,667	△9.1	2,328	63.4	2,352	60.3	1,392	59.6
25 年5月期第3四半期	34,843	10.1	1,424	△30.1	1,467	△22.8	872	△14.2

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26 年5月期第3四半期	41.59	—
25 年5月期第3四半期	26.06	—

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26 年5月期第3四半期	65,335	53,016	81.1
25 年5月期	66,176	52,422	79.2

(参考)自己資本 26 年5月期第3四半期 53,016 百万円 25 年5月期 52,422 百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25 年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
26 年5月期	—	12.00	—		
26 年5月期(予想)				12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成 26 年5月期の業績予想(平成 25 年6月 1 日～平成 26 年5月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	44,500	0.8	2,400	22.8	2,400	15.0	1,400	11.8	41.81

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 有

③ 会計上の見積りの変更 : 有

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は【添付資料】3ページ「(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

26年5月期3Q	35,497,183株	25年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

26年5月期3Q	2,015,791株	25年5月期	2,015,453株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年5月期3Q	33,481,547株	25年5月期3Q	33,481,961株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費に回復の動きが見られ、生産が緩やかに増加し企業収益が改善するなど、回復基調をたどりました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、タブレット端末の需要は概ね堅調でありましたが、スマートフォンの需要が伸び悩むなど、一部に減速感が見られました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は316億6千7百万円と前年同四半期比9.1%の減収となり、営業利益は23億2千8百万円(前年同四半期比63.4%増)、経常利益は23億5千2百万円(同60.3%増)、四半期純利益は13億9千2百万円(同59.6%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、一部に減速感が見られましたものの全体的に緩やかな回復基調で推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、その他の取扱商品において減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、投資その他の資産の減少等により、前事業年度末と比較して8億4千1百万円減少し、653億3千5百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により14億3千5百万円減少し、123億1千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加5億8千9百万円等により、530億1千6百万円となりました。

## (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月期の業績予想につきましては、平成25年9月27日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### (1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更)

当社はシリコンウエハー加工設備（再生ウエハー加工設備を除く）について、設備の使用実態調査の結果を反映して第1四半期会計期間における取得設備より、耐用年数を5年に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

シリコンウエハー加工設備（再生ウエハー加工設備を除く）については、通常の稼働時間を超えて使用することが常態化していることから、増加償却の適用対象となりました。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	20,045	21,529
受取手形及び売掛金	13,256	14,067
商品及び製品	186	176
仕掛品	377	488
原材料及び貯蔵品	948	1,026
その他	780	616
貸倒引当金	△5	△4
流動資産合計	35,589	37,899
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	12,839	12,016
その他(純額)	12,006	12,138
有形固定資産合計	24,846	24,154
無形固定資産	984	800
投資その他の資産		
その他	4,762	2,486
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	4,755	2,480
固定資産合計	30,586	27,435
資産合計	66,176	65,335
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,481	8,718
短期借入金	100	100
未払法人税等	661	257
引当金	58	418
その他	1,604	1,107
流動負債合計	11,906	10,602
固定負債		
長期借入金	350	275
退職給付引当金	1,312	1,261
その他	184	179
固定負債合計	1,846	1,715
負債合計	13,753	12,318

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	18,147	18,736
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	52,339	52,928
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	83	88
評価・換算差額等合計	83	88
純資産合計	52,422	53,016
負債純資産合計	66,176	65,335

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成24年6月1日 至平成25年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自平成25年6月1日 至平成26年2月28日)
売上高	34,843	31,667
売上原価	31,702	27,512
売上総利益	3,140	4,154
販売費及び一般管理費	1,715	1,826
営業利益	1,424	2,328
営業外収益		
受取利息	7	7
受取配当金	4	4
為替差益	140	—
その他	31	20
営業外収益合計	183	33
営業外費用		
支払利息	1	1
設備休止費用	85	3
その他	53	4
営業外費用合計	140	9
経常利益	1,467	2,352
特別利益		
固定資産売却益	—	13
特別利益合計	—	13
特別損失		
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	11	102
特別損失合計	11	102
税引前四半期純利益	1,455	2,263
法人税、住民税及び事業税	320	557
法人税等調整額	263	313
法人税等合計	583	870
四半期純利益	872	1,392

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報  
前第3四半期累計期間 (自 平成24年6月1日 至 平成25年2月28日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	15,993	18,850	—	34,843	—	34,843
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4	—	959	964	△964	—
合計	15,997	18,850	959	35,807	△964	34,843

当第3四半期累計期間 (自 平成25年6月1日 至 平成26年2月28日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	16,728	14,938	—	31,667	—	31,667
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4	—	1,290	1,295	△1,295	—
合計	16,733	14,938	1,290	32,963	△1,295	31,667